

Micron 聯合三星 (Samsung) 打破記憶體壁壘

共同努力加速混合記憶體立方體
介面計畫，促進先進技術與
下一代電子技術快速進步

愛達荷州博伊西和韓國首爾，2011年10月6日（GLOBE NEWSWIRE）--三星電子有限公司和 Micron Technology, Inc.（納斯達克股票代碼:MU），--世界領先的記憶體技術公司 – 今天宣佈創建一家方案團為原始設備製造商(OEM)，推動者和集成商將合作開發和實施革命性新記憶體技術的開放介面規範，該技術被稱為混合記憶體立方體（HMC）。

Micron 和三星是混合記憶體立方體方案團（HMCC）創始成員，將與來自 Altera Corporation、Open Silicon, Inc.和 Xilinx, Inc. 的研究人員緊密合作，共同努力促進行業進步，為市場帶來廣闊的成套技術。該方案團將首先定義規範，使應用範圍適用於從大型網路到工業產品和高性能計算等多種應用。

行業所面臨的主要挑戰之一以及形成 HMCC 的關鍵動力是：高性能電腦和下一代網路設備所需記憶體頻寬的增長速度已經超過了傳統記憶體架構可以提供的極限。“記憶體壁壘”專門用於描述這個問題。突破記憶體壁壘需要新的架構，其可在顯著降低功耗的前提下提高密度和頻寬。

HMC 在性能、包裝和設計效率等方面的能力超出當前和近期的記憶體架構。通過為開發者、製造者和架構師定義行業介面規範，該方案團致力於使 HMC 成為一種新型高性能記憶體技術。

“這次行業協作將為推動有前途的高科技服務，使整個行業受益”，三星半導體公司記憶體行銷和產品規劃副總裁 Jim Elliott 說，“該方案團將有助於改變用於系統設計和製造的系統解決方案，預計該方案將勝過當前提供的記憶體選擇”。

HMC 可能會使記憶體性能達到前所未有的水準，並促進網路、醫療、能源、無線通訊、交通、安全及其他市場的新應用。例如，系統和技術的發展將使其能夠使用可再生能源，支持更高效、可靠和安全的智慧網格基礎結構。

“HMC 不像目前雷達上的任何事物”，Micron 的 DRAM 行銷副總裁 Robert Feurle 說。“HMC 使記憶體性能和效率成指數增長，能力達到全新水準，這將重新定義記憶體的未來。通過行業方案團的指導，將有助於儘快採用該技術，我們相信其結果將根本改善計算系統”。

HMCC 記憶體規格將由方案團成員共同開發。方案團對採用該技術規範的所有成員完全開放，成員有機會儘早接觸到規範草案並參與規範討論和開發。附加資訊、技術規範、工具 and 技術支援可以在 www.hybridmemorycube.org 找到。

關於 HMCC

由世界領先的半導體團體創建，混合記憶體立方體方案團（HMCC）致力於為混合記憶體立方體技術開發行業介面規範。目前，該方案團成員包括 Micron Technology、三星電子、Altera Corporation、Open Silicon, Inc. 和 Xilinx, Inc. 等公司，還有一些其他企業的人會程式正在討論中。請訪問 www.hybridmemorycube.org，以獲得關於 HMCC 的更多資訊。

(C) 2011 年 Micron Technology, Inc. 版權所有。修改資訊無需通知。Micron 和 Micron orbit 的標誌是 Micron Technology, Inc. 商標。所有其他商標均為各自所有者財產。

三星及其獨特的三星設計是三星電子公司的商標和服務標誌。其他商標均為各自所有者財產。

Micron Technology, Inc. 徽標位於
<http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=6950>

聯繫資訊：Micron:

Scott Stevens
+1.512.288.4050
ssstevens@micron.com

Samsung:

美國
John Lucas, APR
Samsung Semiconductor, Inc.
408-544-4363
j.lucas@ssi.samsung.com

美國以外
Sunghae Park
Samsung Electronics
+82-31-209-7037
sunghae_park@samsung.com